



MULTISTUCPANELSYSTEEM

Universeel, dampopen en reversibel sanerend systeem voor probleemondergronden met een gepleisterde afwerking

TOEPASSING

Het Multistucpanelstelsysteem is een bijzonder reversibel sanerend systeem dat bestaat uit een universele, dampopen pleisterdrager (MSP) die wordt afgewerkt met een spanningsverdelende mortel-/weefsellaag en een geschuurde of gepleisterde afwerklaag. Het Multistucpanelstelsysteem wordt toegepast op extreem verontreinigde ondergronden waarbij een regulier (sanerend) pleistersysteem onvoldoende resultaat biedt en waarbij het onverstoord uitdampen van vocht wenselijk is.

Multistucpanel[®] is een zeer open, universele pleisterdrager op basis van polypropyleen voor typische probleemondergronden. Hierbij valt te denken aan ondergronden met optrekkend - en doorslaand vocht, door zout belaste ondergronden, gescheurde of scheurgevoelige ondergronden, gedeformeerd of instabiel (zacht) metselwerk, sterk verontreinigde ondergronden door bijvoorbeeld roet, roest, alg, schimmel en aan geschilderde of vette ondergronden, waarbij geen of nauwelijks hechting van een pleistersysteem tot stand te brengen is. Multistucpanel[®] kan niet worden aangebracht op ondergronden waarbij sprake is van drukkend of levend water en is uitsluitend binnen toepasbaar.

EIGENSCHAPPEN

Multistucpanel[®]:

- Handmatig met behulp van pluggen (MSP-slagplug) aan te brengen
- Thermische uitzetting $150 \cdot 10^{-6} \text{ m/m}^\circ\text{C}$
- LxBxD: 1200 x 600 mm x 25 mm
- Eenvoudig te zagen met een hand- of decoupeerzaag
- Lichtgewicht en scheuroverbruggend
- Gewicht: 1300 gram per plaat
- Celdoorsnede: 8,0 mm
- Drukvastheid: 1,75 MPa
- Maattolerantie: +/- 4,0 mm
- Warmte geleidingsvermogen $\lambda_d = 0,067 \text{ W/(mk)EU}$
- Gegarandeerde isolatie van vochtplekken, zoutuitslag, roest, roet, alg en schimmel enz.

Systeem componenten:

- Multistucpanel[®] (MSP)
- MSP-slagpluggen
- SLP GMS-05 Light
- SLP VWS wapeningsgaas
- KHALIX FIX-kalk
- SLP Silicaatverf
- KHALIX Kalkverf

VOORBEREIDINGEN

Voordat Multistucpanel[®] wordt aangebracht wordt een grondige inspectie van de probleemondergrond aanbevolen. Daar waar mogelijk vervuilingen zoveel mogelijk door afborstelen of afsteken verwijderen en doormiddel van vochtmetingen vaststellen of er geen sprake is van levend of drukkend water (zie toepassing). Bij onvlakke ondergronden vaststellen of er hechting van een vertin- of uitvlaklaag tot stand te brengen is.

ZIE VERVOLG

In dat geval voorafgaand aan de montage van Multistucpanel® eerst een vertin- en uitvlaklaag aanbrengen van SLP MKP-10 Tras. De MKP-10 Tras “onder de rei” brengen en laten drogen. (zie het technisch merkblad van SLP MKP-10 Tras)
Op vlakke probleemondergronden kan Multistucpanel® rechtstreeks, volgens de in deze verwerkingsrichtlijn 2.1 omschreven werkmethode, probleemloos worden aangebracht. Indien u twijfelt aan de toepassingsmogelijkheden van Multistucpanel® kunt u een maatwerkadvies bij SLP/KHALIX aanvragen.

MONTAGE/VERWERKING MULTISTUCPANEL®:

Multistucpanel® dient conform NPR 3924 in halfsteensverband door middel van MSP-slagpluggen op de probleemondergrond te worden aangebracht. Hierbij dient aandacht te worden besteed aan de aansluiting van de Multistucpanel® onderling. De platen dienen strak en nauwkeurig tegen elkaar te worden aangebracht. Doorvoeren van buizen en leidingen enz. eveneens nauwsluitend aanwerken. Minimaal 8 slagpluggen (zie schema) per plaat aanbrengen.

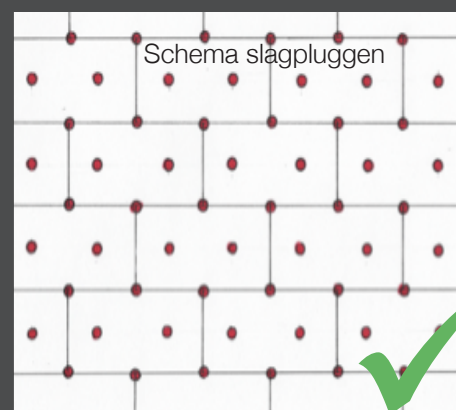
Aandachtspunt:

Multistucpanel® dient zo nauwkeurig en aaneengesloten te worden aangebracht dat de aan te brengen mortel-/weefsellaag niet in contact komt met de ondergrond! Ter verbetering van de brandwerendheid dient een pleistersysteem van minimaal 5 mm te worden aangebracht.



Type: MSP-slagplug

- Kunststof slagpin met structuurschotel
- Lengte: 90 mm
- Voorboren (10 mm) en direct bevestigen
- Verankeringsdiepte: 65 mm
- Aantal: 8 stuks per plaat



Verwerking pleistersysteem:

SLP GMS-05 Light dient verwerkt te worden volgens de algemene richtlijn NPR 3924.1 zak SLP GMS-05 Light (20 kg), zonder toevoegingen, mengen met ca.5 liter leidingwater tot een homogene pleister is ontstaan. Bij een machinale verwerking is de watertoevoeging afhankelijk van het type machine en sneckemantel.

Mortel-weefsellaag:

Een mortel-weefsellaag aanbrengen van SLP GMS-05 Light in een laagdikte van maximaal 4 - 6 mm en direct het SLP VWS wapeningsweefsel zonder vouwen inbedden en “inpleisteren”. Het wapeningsweefsel 100 mm laten overlappen. De SLP GMS-05 Light in de nog plastische fase met een nylon bezem horizontaal ruwhalen. Aansluitend de mortel-/weefsellaag laten drogen. De droogtijd bedraagt ca.1 dag per mm laagdikte.

Afwerklaag: (geschuurde afwerking)

Daar waar gewenst of noodzakelijk SLP dunpleisterprofielen aanbrengen en aansluitend de SLP GMS-05 Light in een gelijkmatige dikte van ca. 2 - 3 mm op de droge en egaal zuigende mortel-/weefsellaag aanbrengen, vlakreien, afmeten en na enige droging opschuren met een licht vochtige, schone schuurspons. Zowel bij de mortel-/weefsellaag als bij de afwerklaag de inwendige hoeken insnijden (zie het technisch merkblad van SLP GMS-05 light).

ZIE VERVOLG

MONTAGE/VERWERKING MULTISTUCPANEL® (VERVOLG):

Pleisterlaag: (gladde afwerking)

Voor een schilderklare eindresultaat is het mogelijk om de afwerklaag te voorzien van "wit" pleisterwerk. Na het aanbrengen en opstijven van de afwerklaag, het geheel "vers in vers" afpleisteren met twee lagen KHALIX FIX-Kalk in een laagdikte van ca. 1-2 mm. (zie technisch merkblad KHALIX FIX-Kalk).

Verfysteem:

Na volledige droging van het pleistersysteem, de ondergrond voorzien van een dampopen SLP Silicaatverf of KHALIX kalkverfysteem. (zie het technisch merkblad van SLP Silicaatverf of KHALIX Fresco '500 kalkverf).



VERWERKERS INFO

Verpakking en verbruik:

Multistucpanel® wordt op pallets verpakt. Met betrekking tot het verbruik: Rekening houden met een snij- /zaagverlies van gemiddeld 7 – 10%. MSP-slagpluggen: 200 stuks per doos.

Opslag:

Multistucpanel®: Op houten pallets, vrij van de grond onbeperkt houdbaar.

Bijzonderheden:

Het pleistersysteem niet verwerken bij te verwachten vorst, een ondergrond- en luchttemperatuur van $< + 5 \text{ °C}$ / $> + 25 \text{ °C}$. Na het aanbrengen het verse pleister tegen vroegtijdig uitdrogen beschermen.

Veiligheid:

Contact met ogen en handen dient door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen te worden vermeden. Bij contact met de ogen direct uitspoelen met leidingwater. Een actueel veiligheidsblad is beschikbaar.

Algemene voorwaarden:

Materiaal technische eigenschappen kunnen alleen worden gegarandeerd indien gebruik wordt gemaakt van alle onderdelen van het SLP pleistersysteem en uitvoering wordt gegeven aan alle facetten zoals deze in de SLP/KHALIX-adviezen worden genoemd. Onze technische merkbladen zijn - onder voorbehoud van wijzigingen en behoud van alle rechten - opgemaakt volgens de laatste stand van de techniek. De gegevens over verbruik en hoeveelheden zijn onder ideale omstandigheden bepaald en dienen derhalve als referentiewaarde te worden gezien. SLP Trading bv. levert uitsluitend volgens haar algemene leveringsvoorwaarden. Vraag een nieuw exemplaar aan als u deze nog niet bezit.

ZIE VERVOLG



DE VOORDELEN VAN MULTISTUCPANEL®:



Lichtgewicht

MSP is een lichtgewicht pleisterdrager met een middenkern van lucht. De plaat weegt slechts 1,3 kg en is hierdoor uiterst eenvoudig en Arbovriendelijk te verwerken. De MSP laat zich eenvoudig zagen of snijden wat de levensduur van het gereedschap verlengt.



Bestand tegen verrotting

MSP is ongevoelig voor vocht, oplosmiddelen, zuren, logen, zouten of andere verontreinigingen die zouden kunnen zorgen voor chemische inwerking. Opzwellings- of aantasting van de plaat is uitgesloten.



Hoge mate van sterkte

MSP biedt een goede weerstand tegen mechanische belasting. De lichtgewicht pleisterdrager heeft een druksterkte van 1,2 N/mm².



Scheuroverbruggend

MSP is samengesteld uit (polypropyleen) visco-elastisch materiaal. Deze taai en elastische kenmerken maakt de plaat scheuroverbruggend en beperkt constructieve scheurvorming.



Thermisch en akoestisch comfort

De luchtkern maakt MSP thermisch isolerend. De open structuur van Multistucpanel® draagt tevens bij aan het akoestisch comfort.



Dampopen

MSP is 100% dampopen zodat opsluiting van vocht niet kan plaatsvinden. Het dampopen karakter van de plaat zorgt ervoor dat de vochtuithouding in de constructie niet wijzigt. Houten elementen in een wand zoals balkkoppen, kozijnen enz. worden hierdoor niet belast en het vochtige metselwerk kan gewoon op natuurlijke wijze drogen.



Uitstekende hechting

MSP is voorzien van een open nonwoven polyester doek waardoor er een uitstekende mechanische aanhechting plaatsvindt tussen de plaat en het aan te brengen pleister.



Milieuvriendelijk

MSP is volledig recyclebaar. In tegenstelling tot de recycling van andere kunststoffen komen er bij de recycling van polypropyleen geen gevaarlijke stoffen vrij.